

インプラントアバットメントへの 補綴装置の接着



通法にしたがい仮着材・仮封材除去、窩洞・支台歯の清掃、防湿等を行ってください。



パナビア® V5

1 補綴装置の処理

無機物フィラーを含むレジン系材料、シリカ系ガラスセラミックス、歯科用陶材の場合



金属、ジルコニア/アルミナ等の金属酸化物系セラミックスの場合



必要に応じて
サンドブラスト※1

サンドブラスト※1

K エッチャント
シリンジの塗布、
5秒後水洗・
乾燥

5秒間処理

「クリアフィル® セラミック
プライマー プラス」塗布、
エアブローで乾燥

待ち時間なしでエアブロー

2 アバットメントへの 「クリアフィル® セラミック プライマー プラス」塗布・ マイルドなエアブローで乾燥



3 補綴装置へのペースト塗布

操作時間

操作時間 (23°C)	2分
-------------	----



4 装着・余剰セメントの除去

光照射で半硬化させる
除去法

又は

小筆による除去法

① 余剰セメントに1ヶ所につき
3~5秒光照射



3~5秒
オ×ク

② 探針等で除去



① 余剰セメントを小筆等で
除去



② マージン部に光照射



マージンに光

光照射については下記表をご参照ください。

5 最終硬化※2

保持時間

37°C	5分
23°C	10分



POINT

※1 アルミナ粒子径、及びサンドブラストの圧力は補綴装置の電子添文等にしたがってください。

※2 光を透過する補綴装置の場合はマージン部を含む補綴装置全体への光照射(照射器と照射時間の関係参照)による最終硬化も可能です。ただしオパークは光照射での最終硬化は行えません。

照射器と照射時間の関係

分類	照射時間
高出力LED照射器	(3秒又は5秒)×2回
LED照射器	10秒
ハロゲン照射器	

光量についてはP.2を参照ください。